

中信证券股份有限公司
关于苏州联讯仪器股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本 2026 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、股东会及董事会议事规则等公司治理制度、股东会及董事会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审计文件、信息披露文件；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账；

（5）对公司高级管理人员进行访谈；

（6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 核心竞争力风险

1、产品研发与技术开发风险

2026 年上半年度，公司研发投入金额为 24,984.90 万元，公司研发投入金额持续增长。按照应用领域分类，公司产品主要应用于光通信、碳化硅功率器件、半导体电性能等领域，未来随着应用领域的拓展、市场需求的变动以及技术水平的提升，公司需结合下游市场需求和行业技术发展趋势，对公司的现有技术和产品进行持续迭代和升级以保持核心竞争力。公司研发项目具有资金投入规模大、技术难度高、项目周期长的特点，如果公司未能及时跟上光通信行业技术迭代速度或发展方向，或未能准确把握功率器件测试、半导体电性能测试的发展趋势或前沿技术发展需求，或存储芯片测试设备等新产品研发或送样验证不及预期，或未来研发资金不足，导致公司产品性能提升和产品矩阵拓展相关的研发项目无法按计划取得成果，甚至出现研发失败的情形，将对公司业务发展造成不利影响。

2、技术人才流失风险

公司所处的行业属于技术密集型、人才密集型产业。随着行业技术水平的不断发展，优秀和高端研发人才的需求缺口将日益扩大。未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势或人力资源政策及内部晋升制度得不到有效执行，公司将无法引进更多的高端技术人才，甚至可能出现现有骨干技术人员流失的情形，从而导致公司无法保持持续创新能力。

3、知识产权保护相关的风险

公司所处行业为知识与技术密集的行业，知识产权至关重要。公司在产品研发过程中，涉及到的专利及非专利技术等知识产权众多，需通过申请专利等方式保护自身核心技术并避免侵犯他人知识产权。但不能排除与竞争对手等相关方产生知识产权争议的可能，亦不能排除公司的知识产权被竞争对手等相关方侵权的可能，此类知识产权争议将有可能对公司的正常经营活动产生不利影响。

（二）经营风险

1、客户集中度较高的风险

2026 年上半年度，公司对前五大客户实现营业收入为 87,019.70 万元，占当期营业收入的比重为 56.83%，集中度相对较高。因公司的经营业绩与主要客户经营情况相关性较高，若未来公司主要客户经营情况发生重大问题或公司与客户合作关系发生变化，公司将面临客户订单减少或流失等风险，进而影响公司生产经营，对公司的经营业绩造成不利影响。

2、产品质量风险

公司下游客户对公司产品的质量要求较高，而公司产品的质量和性能受到原材料、设计、制造、售后服务等多种因素的影响，无法完全排除因不可控因素导致出现产品质量问题。如果公司在产品生产过程中出现性能不稳定或质量问题，可能影响客户的满意度甚至产生质量纠纷、客户流失，将对公司的经营业绩造成不利影响。

3、税收优惠政策变动的风险

公司享受的税收优惠政策主要包括高新技术企业所得税优惠、先进制造业企业增值税加计抵减政策、研究开发费用加计扣除、小微企业税收优惠等。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。

4、经营场所租赁的风险

2026 年上半年度，公司部分生产经营场所通过租赁方式取得。虽然公司对经营场所的租赁行为一直处于持续稳定状态，但不排除出现租赁合同不能继续履行、到期无法续租或租金大幅上涨、租赁过程中发生出租方违约等情形。如果发生上述情形，则公司可能因需要搬迁而产生额外费用，在短期内亦可能会影响公司正常经营。

（三）财务风险

1、毛利率波动风险

2026 年上半年度，公司综合毛利率为 70.79%。公司产品毛利率水平受产品销售价格、销售策略、成本波动、市场竞争等多个因素共同影响，不同产品之间的毛利率存在差异，产品结构占比波动亦会对综合毛利率产生影响。未来，公司如果无法持续进行技术创新或者行业竞争加剧、产品领先优势下降，或者公司产品销售价格、成本控制能力、产品结构发生较大不利变动，都将可能导致公司毛利率水平出现波动，给公司的经营带来一定风险。

2、应收账款坏账损失的风险

2026 年 6 月末，公司应收账款的账面余额为 109,814.21 万元，应收账款坏账准备为 6,855.77 万元。2026 年 6 月末，公司存在部分应收账款逾期情况，公司对存在重大收回不确定性的应收账款单项计提坏账准备。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额可能进一步增加，较高的应收账款余额会影响公司的资金周转效率、限制公司业务的快速发展。如果公司采取的收款措施不力或客户经营状况发生不利变化，则公司应收账款发生逾期及坏账损失风险的可能性将会增加。

3、存货跌价的风险

2026 年 6 月末，公司存货的账面余额为 118,689.62 万元，跌价准备为 3,634.30 万元。随着公司业务规模的持续扩大，预计未来存货规模或将相应上升。虽然公司采用“以销定产，适当备货”的生产模式，以客户订单需求为导向组织生产，但产品从原材料采购、生产出货至客户签收或验收需要经历一定周期，若未来市场环境出现重大不利变化、产品更新迭代或客户需求变化等原因导致公司原材料等出现积压、库存商品等出现滞销或贬值，公司存货将面临产生跌价损失的风险，从而影响公司的经营业绩和财务状况。

4、经营业绩下滑风险

2026 年上半年度，公司营业收入为 153,114.90 万元，归属于母公司股东的净利润为 56,713.34 万元；得益于下游应用领域市场需求持续强劲、高端测试仪器设备国产替代进程提速、公司核心产品性能持续突破并获得境内外优质客户广泛认可、产品线不断丰富并持续拓宽应用场景等因素，公司 2026 年上半年度营业收入实现大幅增长。如未

来受到光通信、碳化硅功率器件、半导体集成电路等行业周期、市场波动、下游市场需求变化、公司新产品的研发和推广不及预期、原材料成本上升、公司研发投入加大、已实施或新增股权激励导致的大额股份支付费用等影响，且公司未能采取有效措施及时应对上述变化，公司将面临经营业绩下滑的风险。

（四）与行业相关的风险

1、贸易环境变化及境外收入和采购波动风险

2026 年上半年度，公司产品出口地包括日本、东南亚等国家或地区，境外收入金额和占比均有所提升；公司将“国际化”作为战略发展的重要一环，持续大力拓展海外市场客户。如果上述出口和原材料采购涉及区域的贸易政策、监管政策未来发生重大不利变化，或受不可控的其他政治、经济因素影响，致使上述区域市场需求和供给出现大幅波动，将影响公司海外市场的开拓和供应链稳定性，进而存在境外收入和采购波动的风险。

2、市场竞争加剧风险

公司主营业务为电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务，具备电子测试仪器和半导体测试设备的自主研发及产业化能力。但是和国际龙头企业相比，公司在市场占有率、产品成熟度、多应用领域经验等方面仍然存在诸多差距；同时，随着行业内其他厂商在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，也不排除出现部分国内厂商抢占市场份额，公司所处行业市场竞争将日趋激烈。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则公司可能无法有效应对激烈的市场竞争，公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

（五）宏观经济及行业周期性波动风险

公司产品和服务目前主要面向光通信及半导体领域。其中，光通信领域主要取决于电信市场、数据中心等基础设施建设的景气程度；半导体行业与宏观经济形势密切相关，其需求直接受到芯片制造及终端应用市场的影响。尽管光通信、半导体行业面临全球化竞争与合作，并属于国家政策大力支持的战略新兴行业，但其受到国内外宏观经济、行业发展规律、行业法规和产业政策等因素的影响，存在一定的周期性。如果未来国内外宏观经济增长放缓或产业政策支持力度减弱使得行业发生周期性波动，可能导致公司产

品的市场需求未来短期内有所下降,从而对公司的业务发展和经营业绩产生一定的不利影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作,本持续督导期间,保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

根据公司 2026 年半年度报告,公司 2026 年上半年度主要财务数据指标及变动原因如下所示:

单位:人民币万元

主要会计数据	2026 年上半年度	2025 年上半年度	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	153,114.90	49,599.00	208.71
归属于上市公司股东的净利润	56,713.34	5,654.38	903.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	56,161.39	5,377.66	944.35
经营活动产生的现金流量净额	54,846.94	-5,833.46	不适用
主要会计数据	2026 年 6 月末	2025 年末	本期末比上年末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	338,767.25	89,725.37	277.56
总资产	553,228.47	179,872.93	207.57
主要财务指标	2026 年上半年度	2025 年上半年度	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	6.63	0.73	808.22
稀释每股收益(元/股)	6.63	0.73	808.22
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	6.56	0.70	837.14
加权平均净资产收益率(%)	31.10	8.00	增加23.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	30.79	7.60	增加23.19个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	16.32	27.48	减少11.16个百分点

2026 年上半年度,公司营业收入增长,主要系受益于人工智能技术发展、全球算力需求提升以及数据中心建设进程加速,高速光通信产品需求持续高速增长,光模块、光芯片厂商扩产意愿强烈,拉动公司通信测试仪器产品及光电子器件测试设备产品的市场需求快速增长,推动公司销售规模和营业收入增长。

2026 年上半年度，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的增长，主要系随着公司营业收入增长、毛利率水平提高，推动公司盈利水平提升。

2026 年上半年度，公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司业务规模增长，盈利水平随之提升，销售回款形成的资金净流入增加所致。

2026 年上半年度，公司研发投入占营业收入的比例有所下降，主要系公司营业收入增速高于研发投入增速，公司持续保持高强度研发投入，2026 年上半年度研发投入金额为 2.50 亿元，同比增长 83.34%。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

（1）技术优势与平台化能力

公司以技术创新为根基，保持高强度研发投入，在光通信测试、功率器件测试与电性能测试、存储芯片测试等领域实现了关键技术的自主研发与突破，通过算法、软件、板卡、芯片与架构设计的深度融合不断突破技术上限并驱动研发成果的快速转化，多款主力产品的核心指标已达业内领先水平，成功打破国际垄断并填补国内相关领域空白。

公司在电子测量仪器和半导体测试设备领域深耕多年并取得了大量原创性的研究成果，建立了以高速信号处理、微弱信号处理、超精密运动控制为核心的具有高复用性的平台级核心技术体系，通过将底层技术与自主研发的软件、硬件及模块化设计架构相结合，组成可同时满足多方面需求的核心功能模块，并通过功能模块的累积，搭建起可高效响应新产品开发需求的技术平台，支持公司快速对产品线进行纵向升级和横向拓展。

（2）产品矩阵优势

自 2017 年成立以来，公司聚焦光模块测试需求相继推出了误码分析仪、采样示波器、时钟恢复单元、光模块测试仪等核心测试仪器，凭借在光模块测试领域的经验积累，公司逐步向上游的光电子器件测试领域拓展业务版图，推出 CoC 光芯片老化测试系统、光芯片 KGD 分选测试系统、硅光晶圆测试系统、OE 芯片 KGD 分选测试系统等光电子器件测试设备，逐步实现光通信产业链中模块、芯片、晶圆等核心环节测试需求的覆盖。

公司依托于光电子器件测试领域的技术沉淀，针对功率器件在车规级应用场景下日益严苛的可靠性要求相继推出晶圆级老化系统、功率芯片 KGD 分选测试系统等测试设备，并在国内实现产业化应用的基础上成功实现品牌出海。同时，公司持续加大存储芯片测试设备等领域的战略布局和投入，大力推进中高速存储芯片测试系统、HBM 芯片 KGD 分选测试系统等产品的研发及产业化应用，有望打开公司下一个增长曲线。

公司高度重视核心基础电性能测试仪器的自研能力，重点攻关精密源表等电性能测试仪器的研发，成功实现精密源表在光通信、半导体等多领域的商业化应用；并重点围绕半导体测试需求，突破精密源表的指标上限并拓宽电性能测试产品线的覆盖面，相继实现 WAT 测试机、晶圆级可靠性测试设备等领域的产业化应用。

（3）客户优势

基于强大的产品与技术实力，公司深度服务全球高速通信和半导体等科技领域知名用户。光通信测试领域，公司已覆盖中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密、源杰科技、度亘核芯、赛丽科技、熹联光芯、粤芯半导体、Lumentum、Coherent、Broadcom、环球广电、日本住友、日本古河等国内外主流光通信产业链客户。功率器件测试领域，公司已覆盖比亚迪半导体、芯联集成、士兰微、长飞先进、株洲中车、ONSEMI、东芝、博世等国内外主流功率芯片厂商。半导体电性能测试领域，公司代表性客户包括比亚迪半导体、燕东微、士兰微、北京电控、X-FAB 等国内外知名企业。上述行业知名用户助力公司各行业领域前沿技术突破，引领公司创新发展。

（4）人才与管理优势

电子测量仪器行业和半导体测试设备行业属于技术密集型行业，行业“Know-How”往往由资深人员掌握，保持核心技术、管理和销售人员稳定的重要性不言而喻，对企业的持续发展至关重要。公司注重人员内部培养和外部人才引进，建立了一支拥有行业领先技术和专业能力、高度认同公司企业文化的核心管理和员工团队。公司核心技术团队稳定，截至 2026 年 6 月末公司研发人员 624 人，并规划持续充实优化研发团队。公司核心技术人员深耕行业多年，拥有扎实的专业能力和丰富的管理经验，能够准确把握行业和公司发展方向，并制定符合公司实际的发展战略，在公司技术研发的演进、市场开拓、企业文化的塑造和推动等方面起到了关键作用。

（5）品牌优势

公司已建立起了健全且优质的研发、采购、生产、销售体系，并持续为客户提供优质的售前、售中及售后服务，成功在业内积累起了良好的口碑，有助于公司保持稳定的客户合作关系并开拓优质的下游客户。

自设立以来，公司已获得多项荣誉，塑造了良好的品牌形象，取得“国家级专精特新‘小巨人’企业”、“江苏省瞪羚企业”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省潜在独角兽企业”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省企业工程技术研究中心”、“苏州市‘独角兽’培育企业”等多项荣誉。

（6）全球化业务布局优势

公司依靠突出的产品性能、交付效率和技术服务优势，在全球业务布局上取得了突出成就。公司全球化战略以境外销售业务为重心，从技术支持、售后服务以及供应链各方面全方位实现出海，大幅提升响应速度与本地化支持能力。

公司于 2022 年进军日本市场，逐步实现产品出海并积累宝贵的在地化服务经验；2023 年以来，公司在东南亚地区相继设立新加坡办公室、马来西亚制造中心、泰国技术服务中心，在紧随国内头部客户出海步伐的同时，加快导入国际顶尖客户群体，努力提升本土化交付能力与服务水平；2025 年以来，在已经具备一定国际市场规模的基础上，公司于美国、韩国设立子公司，继续提升全球化交付能力。通过输出核心产品、技术与服务优势，公司全方位赋能境外市场，并聚焦国际头部用户需求不断进行技术创新与产品优化。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2026 年 上半年度	2025 年 上半年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	24,984.90	13,627.58	83.34

资本化研发投入	/	/	/
研发投入合计	24,984.90	13,627.58	83.34
研发投入总额占营业收入比例（%）	16.32	27.48	减少 11.16 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	/	/	/

公司通过技术创新与持续研发保持核心竞争力，聚焦核心技术突破，报告期内保持高强度研发投入，推进下一代高速通信测试仪器、CPO 全环节测试仪器设备、存储芯片测试设备、高精度电性能测试仪器设备、高端电子测量仪器等各产品线的拓展以及产品性能升级突破，持续追赶国际领先水平。

（二）研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高速存储芯片测试系统	15,000.00	4,579.73	7,731.10	进行中	开发全新的高速存储芯片测试系统，满足DDR5、LPDDR5、LPDDR5X、DDR6 和 LPDDR6 等高速存储颗粒的 FT 测试需求，速率达到18Gbps，通道数量达到 28K	国际先进	应用于存储芯片测试，下游面向 AI 计算中心、互联网、大模型等领域
2	HBM 芯片 KGD 分选测试系统	10,000.00	2,725.20	4,861.69	进行中	开发全新的 HBM 芯片裸 Die 分选测试系统，满足 HBM 芯片裸 Die 的分选测试需求，系统探针定位精度 $\leq \pm 6.5\mu\text{m}$ ，集成全自动系统提升客户产能，兼容主流 HBM /SoC 测试机	国际先进	
3	OE 芯片 KGD 分选测试系统	6,500.00	2,057.52	2,926.41	进行中	开发全新的 OE 芯片 KGD 分选测试系统，满足 OE 芯片裸 Die 与光插拔 OE 芯片的双面高速光电测试需求，且根据不同 OE 芯片形态开发对应的测试系统	国际先进	
4	采样示波器	10,000.00	1,922.88	4,556.73	进行中	开发新一代单波 400Gbps 采样示波器，满足 2.4T/3.2T 光模块的眼图测试需求，向下兼容 1.6T/800G/400G 测试应用，同时支持 PON、DWDM 等方向的应用	国际领先	应用于光互联测试，下游面向 AI 计算中心、电信网络等领域
5	CoC 光芯片老化测试系统	3,500.00	1,367.77	2,751.54	进行中	开发新一代 CoC 光芯片老化测试系统，实现上下料、测试、老化全自动集成，且支持 AOI 功能，最高可以支持 7,296 颗 CoC 光芯片并行测试，大幅提升系统产能	国际领先	
6	光芯片 KGD 分选测试系统	6,000.00	1,329.64	2,971.55	进行中	开发新一代光芯片 KGD 分选测试系统，进一步提升 UPH、自动化水平、温度兼容性等产品性能	国际领先	
7	WAT 测试机	10,000.00	1,458.55	5,195.62	进行中	开发新一代通用并行 WAT 测试机，实现 100Pin 的并行测试资源，单 Pin 集成高精密源表、高压脉冲发生器及频率测试单元为一体，支持 Fast Vt 高速测试功能，以满足半导体先进制程对高吞吐量、高效率并行测试要求	国际先进	应用于高精度电性参数测试，下游面向半导体、通信、计算机、汽

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
8	精密源表	8,000.00	998.68	4,729.37	进行中	1、持续迭代精密源表产品电流、电压、功率、分辨率等各项性能指标； 2、开发新一代脉冲源表，实现 100ns 脉宽脉冲电流源，满足激光器芯片低热耗的测试需求； 3、开发新一代高通道密度源表，实现多通道情况下高分辨率的测试要求，满足硅光芯片的测试需求；实现较多通道情况下大电流、大电压、高电压/电流分辨率的测试要求，满足射频器件的测试需求	国际先进	车电子、工业等领域
9	半导体综合参数分析仪	3,500.00	798.09	1,803.33	进行中	开发全新的全国产化半导体综合参数分析仪，电流测量最高分辨率达到 0.1fA，完成高功率精密源表模组、高分辨率精密源表模组、高分辨率/多频点电容测量模组、高压高速脉冲产生模组、任意波信号产生及同步测量模组等核心硬件模块的产品化开发，解决半导体集成电路电性能参数测试领域对核心软硬件资源全国产化的需求	国际先进	
10	实时示波器	22,000.00	2,397.13	10,214.50	进行中	开发新一代高性能实时示波器，满足从高速 SerDes 到 PCIe6.0、HDMI2.0、USB4.0 的性能与协议测试需求，实现高带宽、高采样率、高存储深度、多通道的示波器技术平台	国际先进	应用于高速信号产生与测量，下游面向电子测量等领域
11	晶圆级老化系统	7,000.00	1,177.06	5,826.47	进行中	开发新一代晶圆级老化系统，同时支持 HTGB&HTRB，进一步提升测试项目、工位数、自动化水平等产品性能	国际领先	应用于碳化硅功率器件测试，下游面向新能源汽车等电力电子领域
12	功率芯片 KGD 分选测试系统	8,500.00	880.53	5,585.28	进行中	开发新一代功率芯片 KGD 分选测试系统，进一步提升 UPH、上下料方式兼容性、温度兼容性、AOI 功能等产品性能	国际领先	
13	其他	/	3,292.13	/	/	/	/	/
合计	/	/	24,984.90	/	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度与原计划基本一致，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

本持续督导期内，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州联讯仪器股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

赵 耀

周 欢

中信证券股份有限公司

2026年9月11日